

SEMICONDUCTOR DEVICE

Patent Number: JP8046186

Publication date: 1996-02-16

Inventor(s): TSUKAMOTO MASANORI

Applicant(s): SONY CORP

Requested Patent: JP8046186

Application Number: JP19940175526 19940727

Priority Number(s):

IPC Classification: H01L29/78; H01L21/28; H01L21/027; H01L21/3205

EC Classification:

Equivalents:

Citation 4

Abstract

PURPOSE: To prevent hydrogen from being diffused into a gate insulating film with an antireflection film constituted of an SiOn thin film being kept existing by letting a gate electrode include a titanium layer.

CONSTITUTION: On an Si substrate 1 where element isolation regions 2 and a gate insulating film 3 are formed, a gate electrode 9 which is constituted of a polysilicon layer 4, a Ti layer 5 and a titanium silicide layer 6 which is put between the other two layers 4 and 5 is formed. On the gate electrode 9, an antireflection film 7 constituted of an SiOn system thin film is deposited in the same pattern as the gate electrode 9. Due to this structure, a hot carrier resistance is remarkably increased compared with the conventional MOS transistor which has no Ti layer 5 in the gate electrode 9. Therefore, even if the antireflection films 7, 18 which are constituted of SiOn system thin films are kept existing, hydrogen is prevented by the Ti layer 5 included in the gate electrode 9 from reaching the gate insulating film 3.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に、少なくとも、ゲート絶縁膜、ゲート電極、酸窒化シリコン系薄膜、上層配線が形成されてなる半導体装置において、

前記ゲート絶縁膜と前記酸窒化シリコン系薄膜との間に、水素透過防止膜が設けられてなることを特徴とする半導体装置。

【請求項2】 前記ゲート絶縁膜が酸化シリコン系材料膜であることを特徴とする請求項1記載の半導体装置。

【請求項3】 前記酸窒化シリコン系薄膜は、前記ゲート電極をバーニングする際の反射防止膜であり、該ゲート電極と共にバーニングをもって積層されてなることを特徴とする請求項1または請求項2記載の半導体装置。

【請求項4】 前記水素透過防止膜が、前記ゲート電極と共にバーニングをもって該ゲート電極上に設けられることを特徴とする請求項3記載の半導体装置。

【請求項5】 前記酸窒化シリコン系薄膜は、前記上層配線をバーニングする際の反射防止膜であり、該上層配線と共にバーニングをもって積層されてなることを特徴とする請求項1または請求項2記載の半導体装置。

【請求項6】 前記水素透過防止膜が、前記ゲート電極を被覆することなく設けられることを特徴とする請求項5記載の半導体装置。

【請求項7】 前記水素透過防止膜が、前記ゲート電極と前記上層配線との間の層間絶縁膜として設けられることを特徴とする請求項6記載の半導体装置。

【請求項8】 前記水素透過防止膜が、LPCVD法によって成膜された窒化シリコン系薄膜であることを特徴とする請求項1ないし請求項7のいずれか1項に記載の半導体装置。

【請求項9】 前記水素透過防止膜が、高密度プラズマCVD法によって成膜された酸化シリコン系薄膜であることを特徴とする請求項1ないし請求項7のいずれか1項に記載の半導体装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、反射防止膜として酸窒化シリコン(SiON)系薄膜を用いてバーニングがなされた半導体装置に関し、特にSiON系薄膜に含有される水素による電気特性の劣化が防止されたものである。

【0002】

【従来の技術】 半導体装置の配線材料としては、アルミニウム(A1)系合金や高融点金属シリサイド等が広く用いられているが、これらの光反射率の高い材料層の表面には、フォトリソグラフィの精度を向上させる目的で反射防止膜を設けることが必須となりつつある。これは、半導体装置のデザイン・ルールの微細化に伴ってフォトレジスト塗膜に対する露光波長が短波長側へシフトし、しかもパターン寸法がその露光波長に近づいている

ため、光反射率の高い材料層の上では安定した解像を達成することが困難となっているからである。

【0003】 特にエキシマ・レーザ光のように単色性の強い露光源を用いた場合、反射防止膜を設けないと、定在波効果が強く現れてレジスト・パターンの変形が生じたり、得られる配線パターンの線幅が変動しやすくなる。

【0004】 反射防止膜としては、その光学定数を任意に設定できることから、SiON系薄膜を用いることが

10 注目されている。このSiON系薄膜は、例えばプラズマを用いた化学気相成長(CVD)法によって成膜することができ、膜中の原子組成比を変化させることによって、光学定数の制御が行えることから、上記エキシマ・レーザ光を用いたフォトリソグラフィへの適用も可能である。

【0005】 ここで、フォトリソグラフィに際して用いられたSiON系薄膜よりなる反射防止膜が存続された半導体装置として、負荷用の薄膜トランジスタ(TFT)のゲート電極と記憶ノードとの接続が自己整合的に

20 開口されたコンタクト・ホールを介してなされたSRAMを図9に示す。このSRAMは、シリコン(Si)基板1上の隣接する2つのゲート電極2間にてSiO系層間絶縁膜3にコンタクト・ホール4が自己整合的に開口され、該コンタクト・ホール4を埋め込みながらポリシリコン配線層6が成膜されることによって、Si基板1とポリシリコン配線層6とが電気的に接続するものである。図示されていないが、このSRAMにおいては、ゲート電極2のバーニングに用いられた反射防止膜が存続されている。

30 【0006】 以下、図9～図11を用いて、反射防止膜が用いられたプロセスについて説明する。先ず、図10に示されるように、Si基板1上に熱酸化によってゲート絶縁膜7を形成した後、続いて、ポリシリコン層8、タングステンシリサイド層9を成膜し、該タングステンシリサイド層9上に反射防止膜10を成膜してから、オフセット酸化膜11を成膜し、さらに、フォトレジスト塗膜12を形成する。そして、反射防止膜10によりタングステンシリサイド層9からの強い反射光を防止しながら、フォトレジスト塗膜12の選択露光を行う。その後、現像処理を経て形成されたフォトレジスト・パターンをマスクとして、オフセット酸化膜11、反射防止膜10、タングステンシリサイド層9、ポリシリコン層8を順にエッチングすることによって、図11に示されるように、ゲート電極2が所望形状にバーニングされる。

40 【0007】 その後、サイドウォール13、SiO系層間絶縁膜3を形成し、隣接するゲート電極2間に自己整合的にコンタクト・ホール4を開口し、該コンタクト・ホール4を埋め込みながらポリシリコン配線層6を成膜させ、さらに該ポリシリコン配線層6のバーニングを

行うことにより、図9に示されたSRAMとなる。

【0008】なお、これらゲート電極2形成後の工程においても、フォトリソグラフィを行うに際しては、タンゲステンシリサイド層9からの反射光が防止されていることが好ましく、先に形成されたゲート電極2上の反射防止膜10が役立っている。

【0009】そして、以上のような構成を有するSRAMにおいては、さらに上層配線を形成するに際しても、SiON系薄膜よりなる反射防止膜が用いられる。具体的には、先ず、図12に示されるように、ポリシリコン配線層6を被覆してSiO系層間絶縁膜14を形成し、該SiO系層間絶縁膜14にピア・ホール15を開口し、該ピア・ホール15を埋め込みながら全面に亘ってA1配線層17を成膜した後、該A1配線層17をパターニングするに際して反射防止膜18を用いる。

【0010】即ち、A1配線層17の成膜後、フォトレジスト塗膜19を塗布する前に反射防止膜18を成膜しておくことにより、A1配線層17からの強い反射光が防止された状態にて、フォトレジスト塗膜19の選択露光が行え、この結果、A1配線層17を所望の配線形状にパターニングできる。なお、該A1配線層17とポリシリコン配線層6とは、ピア・ホール15に埋め込まれたA1プラグ16によって電気的に接続される。

【0011】さらに、上述のようにしてパターニングされたA1配線層17上にさらに配線を形成する場合にも、やはり反射防止膜が必要となる。即ち、図13に示されるように、上記A1配線層17を被覆して形成されたSiO系層間絶縁膜20にピア・ホールを開口する場合にも、フォトレジスト塗膜21の選択露光時に、A1配線層17からの強い反射光が防止されている必要があるからである。このため、A1配線層17上の反射防止膜18を、A1配線層17のパターニング後にも存続させておき、フォトレジスト塗膜21の選択露光に際して再び用いる。

【0012】以上のように、このSRAMの製造プロセスにおいては、フォトレジスト塗膜12、19、21の選択露光に際して、SiON系薄膜よりなる反射防止膜10、18が下層からの反射光の影響を抑制している。

【0013】

【発明が解決しようとする課題】ところで、上述のようにして製造されたウェハにおいては、ゲート電極2上、A1配線層17上に、それぞれ反射防止膜10、18として、SiON系薄膜が存続された状態となっている。このSiON系薄膜には、20%程度もの水素が含有されており、該反射防止膜10、18が成膜された後、不純物の活性化アーナールやバッシベーション等の工程において熱が加えられることにより、水素が周囲へ拡散するといった現象が起こる。そして、このようにして拡散した水素がゲート絶縁膜7にまで達すると、いわゆるホットキャリア耐性を劣化させる虞れがある。

【0014】これを防止するには、反射防止膜を使用する度に、これをエッティング除去することが考えられるが、反射防止膜とその直下の材料層との選択比がとれなかつたり、同一の反射防止膜を1回しか使用することができないため、フォトリソグラフィを行う度に反射防止膜の成膜工程を要することになるといった問題もある。

【0015】そこで本発明は、かかる従来の実情に鑑みて提案されたものであり、SiON系薄膜よりなる反射防止膜を存続させたままでも、ゲート絶縁膜への水素の拡散が防止できる構造を有する半導体装置を提供することを目的とする。

【0016】

【課題を解決するための手段】本発明に係る半導体装置は、上述の目的を達成するために提案されたものであり、基板上に、少なくとも、ゲート絶縁膜、ゲート電極、SiON系薄膜、上層配線が形成されてなる半導体装置において、ゲート絶縁膜とSiON系薄膜との間に、水素透過防止膜が設けられてなるものである。特に、Si基板上にSiO系材料膜よりなるゲート絶縁膜が形成されている場合に、上述のごとく水素透過防止膜が設けられて好適である。

【0017】SiON系薄膜をプラズマCVDにて成膜すると、原料ガスの流量比に基づいてその原子組成比を調整できるため、その光学定数を制御することができる。このため、SiON系薄膜を反射防止膜として設けると、下地材料層や使用する露光光に応じた最適な露光が行える。

【0018】特に、ゲート電極を微細にパターニングするためのフォトリソグラフィに際しては、ゲート電極を構成する材料層からの反射光を防止するために、反射防止膜としてSiON系薄膜が設けられる。そして、この反射防止膜をフォトリソグラフィ後も存続させれば、該反射防止膜はゲート電極と共にバターンをもって積層されることとなる。

【0019】この場合、該反射防止膜から拡散していく水素をゲート絶縁膜に到達させないためには、ゲート電極と共にバターンをもって該ゲート電極上、且つ、反射防止膜下に水素透過防止膜が設けられて好適である。なお、ゲート電極の側面を被覆するサイドウォールが設けられる場合には、該サイドウォールにも水素透過を防止できる機能を持たせるとさらに効果的である。

【0020】また、上層配線のパターニングするためのフォトリソグラフィに際しても、A1等の光反射率の高い上層配線からの強い反射光を防止するために、反射防止膜としてSiON系薄膜が設けられる。そして、この反射防止膜をフォトリソグラフィ後も存続させれば、該反射防止膜は上層配線と共にバターンをもって積層されることとなる。なお、上層配線上にさらに層間絶縁膜を設け、該層間絶縁膜のパターニングのためのフォトリソグラフィを行うならば、前記上層配線上に存続する反射

防止膜によって、再び上層配線からの反射光を防止することができる。

【0021】このように上層配線上に反射防止膜が積層されている場合、反射防止膜の形成範囲は必ずしもゲート電極の形成範囲とは同一でなく、該上層配線が存在するあらゆる方向からゲート絶縁膜へ向かって反射防止膜に含有されていた水素が拡散してくることとなる。このため、水素透過防止膜は、あらゆる方向からの水素透過を防止できるように、ゲート電極を被覆するごとく設けられて好適である。

【0022】ところで、前記水素透過防止膜は、L P - CVD法によって成膜されたSiN系薄膜、または、高密度プラズマCVD法によって成膜されたSiO系薄膜であることが好ましい。これらの薄膜は、非常に緻密な膜として成膜できるため、水素の透過を防止できる。なお、高密度プラズマCVD法としては、有磁場マイクロ波プラズマ（E C R）CVD法、ヘリコン波プラズマCVD法、誘導結合プラズマ（I C P）CVD法が挙げられる。

【0023】なお、水素透過防止膜をゲート電極と共にバターンをもってゲート電極上に形成するには、ゲート電極を構成する例えばポリシリコン層およびタンクステンシリサイド層を成膜後、続けて、上述の方法のいずれかによって水素透過防止膜を成膜し、さらに反射防止膜を成膜してから、フォトリソグラフィおよびエッチングを行い、所望形状にゲート電極のバーニングを行えばよい。

【0024】また、水素透過防止膜をゲート電極を被覆するごとく設けるには、ゲート電極の形成後、あるいは、オフセット酸化膜やサイドウォールにて該ゲート電極を被覆するならばこれらを形成後、L P - CVD法にてSiN系薄膜を全面に亘って成膜するか、あるいは、層間絶縁膜として、高密度プラズマCVD法によってSiO系薄膜を成膜するとよい。

【0025】

【作用】本発明に係る半導体装置においては、水素透過防止膜が設けられることにより、SiON系薄膜から拡散する水素がゲート絶縁膜へ到達しにくくなされている。このため、従来の半導体装置に比して、ホットキャリア耐性を大幅に向上させることができる。

【0026】特に、SiON系薄膜がゲート電極のバーニングに際して用いられ、その後も存続されている場合、ゲート絶縁膜に非常に近い位置にて水素の拡散が起ることとなるが、該SiON系薄膜よりも下方にゲート電極と共にバターンを有する水素透過防止膜が設けられることにより、ホットキャリア耐性の劣化を防ぐことができる。

【0027】これは、Si基板において実際にチャネルとなるのは、ゲート電極のエッジよりもさらに内側の領域であり、この領域上のゲート絶縁膜への水素の到達が

防がれれば、ホットキャリア耐性の劣化が抑制できるからである。即ち、SiON系薄膜がゲート電極と共にバターンにて存続する場合には、同様にこれと共にバターンを有する水素透過防止膜により、少なくともゲート電極が形成されている領域におけるゲート絶縁膜への水素到達が防止できるからである。

【0028】また、SiON系薄膜が上層配線のバーニングに際して用いられ、その後も存続されている場合、上層配線が存在するあらゆる方向からゲート絶縁膜へ向かって反射防止膜に含有されていた水素の拡散が起ることとなるが、ゲート電極を被覆するごとく水素透過防止膜を設けることにより、ホットキャリア耐性の劣化を防ぐことができる。

【0029】これは、水素透過防止膜がゲート電極を被覆するごとく設けられることにより、ゲート絶縁膜も該水素透過防止膜によって被覆されるため、どの方向から水素が拡散してきてもゲート絶縁膜への到達を防止できるためである。

【0030】なお、層間絶縁膜に水素透過防止膜としての機能を持たせる場合には、工程数の増加を伴わない。

【0031】上述したような水素透過防止膜として、L P - CVD法によって成膜されたSiN系薄膜、高密度プラズマCVD法によって成膜されたSiO系薄膜を用いると、これらが非常に緻密な膜であるために、水素の透過防止効果が高く、半導体装置の信頼性が向上する。

【0032】

【実施例】以下、本発明を適用した具体的な実施例について、図面を参照しながら説明する。

【0033】実施例1

30 本実施例は、MOS型トランジスタに本発明を適用したものであり、ゲート電極のバーニングに用いられた反射防止膜から拡散する水素をゲート絶縁膜に到達させないために、反射防止膜の下層、且つ、ゲート電極の上層に、該ゲート電極と共にバターンをもって水素透過防止膜が成膜されてなるものである。

【0034】このMOS型トランジスタの一部を図1に示す。ゲート電極2は、Si基板1上のゲート絶縁膜7の上に形成されており、ポリシリコン層8およびタンクステンシリサイド層9よりなる。そして、該ゲート電極2上にはSiN系薄膜よりなる水素透過防止膜22、SiO系薄膜よりなる反射防止膜10、酸化シリコンよりなるオフセット酸化膜11が順に設けられており、その側面はサイドウォール13にて被覆されている。

【0035】このようなMOS型トランジスタについて、電気特性の測定を行ったところ、従来のMOS型トランジスタに比して大幅にホットキャリア耐性が向上した。これは、SiON系薄膜よりなる反射防止膜10が存続されているにもかかわらず、水素透過防止膜22によって、少なくともゲート電極2直下のゲート絶縁膜7へは水素の到達が防止されたためである。

【0036】以下、上述のような構成を有するウェハの製造プロセスについて、図2、図3を参照しながら説明する。先ず、図2に示されるように、Si基板1上に熱酸化によりゲート絶縁膜7を形成した後、ポリシリコン層8、タングステンシリサイド層9、水素透過防止膜22、反射防止膜10、オフセット酸化膜11をそれぞれCVD法によって成膜した。なお、水素透過防止膜22および反射防止膜10の成膜は下記の条件にて行った。

【0037】水素透過防止膜の成膜条件

成膜装置：LP-CVD装置

原料ガス：SiH₄ Cl₂ 50 sccm

NH₃ 200 sccm

温度：760°C

圧力：70 Pa

反射防止膜の成膜条件

成膜装置：平行平板型プラズマCVD装置

原料ガス：SiH₄ 50 sccm

NO₂ 50 sccm

温度：360°C

圧力：333 Pa

RF電力：190 W

電極間距離：1 cm

その後、上述のウェハに対してフォトレジスト塗膜12を全面に亘って塗布し、反射防止膜10によりタングステンシリサイド層9からの強い反射光を防止しながら、フォトレジスト塗膜12の選択露光を行った。続いて、現像処理を施すことによりフォトレジスト塗膜12を所望の形状にパターニングし、これをマスクとして、オフセット酸化膜11、反射防止膜10、水素透過防止膜22、タングステンシリサイド層9、ポリシリコン層8をエッチングした。これにより、図3に示されるように、所望形状のゲート電極2が形成され、該ゲート電極2上では水素透過防止膜22、反射防止膜10、オフセット酸化膜11がゲート電極と共にパターンにパターニングされた。

【0038】続いて、SiO系材料層をウェハの全面に亘って成膜し、異方性エッチングを行うことにより、ゲート電極2から水素透過防止膜22、反射防止膜10、オフセット酸化膜11に亘る側面にサイドウォール13を形成し、図1に示すようなウェハを製造した。なお、MOS型トランジスタを完成させるための後工程についての説明は省略するが、従来公知の方法にしたがって、不純物の拡散および活性化、上層配線の形成等を行った。

【0039】実施例2

本実施例は、負荷用TFTのゲート電極と記憶ノードとが、Si基板上のSiO系層間絶縁膜に自己整合的に開口されたコンタクト・ホールによって接続されてなる多層配線構造のSRAMに本発明を適用したものであり、上層配線のパターニングに用いられた反射防止膜から拡

散する水素をゲート絶縁膜に到達させないために、ゲート電極を被覆するごとく水素透過防止膜が設けられたものである。

【0040】このSRAMの部分断面を図4に示す。実施例1と同様にして設けられた隣接する2つのゲート電極2は、オフセット酸化膜11やサイドウォール13によって被覆され、この2つのゲート電極2の間には、自己整合的にコンタクト・ホール4が形成されており、オフセット酸化膜11やサイドウォール13の周囲にはSiN系薄膜よりなる水素透過防止膜23が形成されている。

【0041】そして、この上方にはSiO系層間絶縁膜3、ポリシリコン配線層6、SiO系層間絶縁膜14、A1配線層17、SiON系薄膜よりなる反射防止膜18が順に積層されている。なお、Si基板1とポリシリコン配線層6とは、2つのゲート電極2間に開口したコンタクト・ホール4に埋め込まれたポリシリコンプラグ5により電気的に接続され、上記ポリシリコン配線層6とA1配線層17とは、ピア・ホール15に埋め込まれたA1プラグ16によって電気的に接続されている。

【0042】このような構成を有するSRAMについて、電気特性の測定を行ったところ、従来のSRAMに比して大幅にホットキャリア耐性が向上した。これは、SiON系薄膜よりなる反射防止膜18が存続されているにもかかわらず、水素透過防止膜23がゲート絶縁膜7の上方のみならず側方をも覆っているため、ゲート絶縁膜7へ向かう全ての水素の透過が防止され、ゲート絶縁膜7への水素の到達が起らなかったからである。

【0043】ここで、このような構成を有するウェハの製造プロセスについて、図5、図6を用いて説明する。先ず、実施例1に示したようにして、オフセット酸化膜11やサイドウォール13に被覆された隣接する2つのゲート電極2を形成した後、SiN系薄膜よりなる水素透過防止膜23を全面に亘って成膜した。なお、水素透過防止膜23の成膜は、実施例1にてタングステンシリサイド層9上に設けた水素透過防止膜22と同様の成膜条件にて行った。

【0044】その後、図5に示されるように、隣接する2つのゲート電極2間にてSiO系層間絶縁膜3にコンタクト・ホール4を開口し、Si基板1に電気的に接続するポリシリコン配線層6を形成した。具体的には、SiO系層間絶縁膜3を全面に亘って成膜した後、図示しないフォトレジスト塗膜を形成して、該フォトレジスト塗膜に、隣接する2つのゲート電極2間の距離よりも大きな開口パターンを形成した。そして、このフォトレジスト・パターンをマスクとして、SiO系層間絶縁膜3を水素透過防止膜23との選択比をとりながらエッチングして、自己整合的にコンタクト・ホール4を開口した。次いで、該コンタクト・ホール4を埋め込みながらポリシリコン配線層6を成膜し、さらに該ポリシリコン

配線層6のバーニングを行って所望の配線形状とした。これにより、Si基板1とポリシリコン配線層6とが、コンタクト・ホール4に埋め込まれたポリシリコンプラグ5によって電気的に接続された。

【0045】次に、図6に示されるように、上記ポリシリコン配線層6に電気的に接続するA1配線層17を形成した。具体的には、上記ポリシリコン配線層6を被覆してSiO系層間絶縁膜14を形成し、該SiO系層間絶縁膜14にピア・ホール15を開口した後、該ピア・ホール15を埋め込みながら、全面に亘ってA1配線層17を成膜した。さらにSiON系薄膜よりなる反射防止膜18を成膜し、フォトレジスト塗膜19を塗布して、該A1配線層17からの強い反射光を防止しながら、選択露光を行い、統いて現像処理することによって該フォトレジスト塗膜19を所望形状にバーニングした。その後、該フォトレジスト塗膜19をマスクとして、反射防止膜18およびA1配線層17をエッチングして、所望の配線形状にバーニングした。これにより、ポリシリコン配線層6と所望形状のA1配線層17とが、ピア・ホール15に埋め込まれたA1プラグ16によって電気的に接続された。

【0046】以上のようにして、図4に示されたウェハが製造できた。上記A1配線層17上の反射防止膜18は除去されてもよいが、工程数を増加させることになる。また、図7に示されるように、ウェハ上にSiO系層間絶縁膜20を形成し、該SiO系層間絶縁膜20にピア・ホールを開口するためのバーニングを行う場合、該SiO系層間絶縁膜20上に塗布されたフォトレジスト塗膜21を選択露光するに際して、A1配線層17からの強い反射光が防止されている必要があり、反射防止膜18を存続させておくことにより、再度用いることができる。このため、本実施例においては、反射防止膜18を存続させた。

【0047】実施例3

本実施例も多層配線構造のSRAMに本発明を適用したものであり、上層配線のバーニングに用いられた反射防止膜から拡散する水素をゲート絶縁膜に到達させないために、ゲート絶縁膜よりも上方に設けられた層間絶縁膜に水素透過防止膜としての機能を持たせたものである。

【0048】このSRAMの部分断面を図8に示すように、水素透過防止膜23が設けられず、SiO系層間絶縁膜3の代わりに水素透過防止層間絶縁膜24が設けられた以外は、実施例2と同様の構成を有している。

【0049】以上のような構成を有するSRAMについて、電気特性の測定を行ったところ、従来のSRAMに比して大幅にホットキャリア耐性が向上した。これは、SiON系薄膜よりなる反射防止膜18が存続されているにもかかわらず、水素透過防止層間絶縁膜24がゲート絶縁膜7の上方のみならず一方の側方をも覆っている

ため、ゲート絶縁膜7へ向かう殆どの水素の透過が防止され、ゲート絶縁膜7への水素の到達が起こりにくかつたためである。

【0050】このような構成を有するウェハを製造するには、先ず、実施例1に示したようにして、オフセット酸化膜11やサイドウォール13に被覆された隣接する2つのゲート電極2を形成した後、水素透過防止層間絶縁膜24を全面に亘って成膜した。なお、水素透過防止層間絶縁膜24の成膜は下記の条件にて行った。

10 【0051】水素透過防止層間絶縁膜の成膜条件

成膜装置：ECR-CVD装置

原料ガス：SiH₄ 50 sccm

O₂ 1000 sccm

マイクロ波電力：1000W

RFバイアス電力：500W

圧力：1×10⁻³ torr

その後、実施例2と同様にして、2つのゲート電極2間に、Si基板1と電気的に接続するポリシリコン配線層6を形成し、さらに、該ポリシリコン配線層6に電気的に接続するA1配線層17を形成した。

【0052】以上のようにして、図8に示されたウェハが製造できた。このウェハにおいても、A1配線層17のバーニング後、該A1配線層17を被覆して設けられるSiO系層間絶縁膜にピア・ホールを開口するためのバーニングに際しても上記反射防止膜18を再度使用できることから、該反射防止膜18を存続させたままとした。

【0053】以上、本発明に係る半導体装置を適用した具体例について説明したが、本発明は上述の実施例に限定されるものではなく、種々の変形変更が可能である。

例えば、実施例1においては、サイドウォール13を常法に従って形成したが、このサイドウォール13をLPCVD法にて成膜されたSiN系材料層や、高密度プラズマCVD法にて成膜されたSiO系材料層から構成すれば、ゲート絶縁膜7に向かって横方向から拡散してくる水素の透過を防止することもできる。また、実施例2および実施例3においては、ゲート電極2上に水素透過防止膜22が設けられている上に、さらに水素透過防止膜23または水素透過防止層間絶縁膜24が設けられてなるが、ゲート電極2のバーニング寸法が大きく、該ゲート電極2のバーニングに際して反射防止膜10を必要としない場合には、該ゲート電極2上の水素透過防止膜22が設けられなくともよい。また、ウェハの構成や各材料層の成膜条件も上述した実施例に限られない。

【0054】

【発明の効果】以上の説明から明らかなように、本発明に係る半導体装置においては、SiON系薄膜から拡散する水素がゲート絶縁膜へ到達しにくい。このため、従来の半導体装置に比してホットキャリア耐性が大幅に向う。

【0055】また、本発明の半導体装置においては、上述したようにSiON系薄膜の存続によるホットキャリア耐性の劣化が防がれているため、該半導体装置を製造するに際して、SiON系薄膜の除去工程を削減できる。また、SiON系薄膜を存続させることにより、該SiON系薄膜を次のフォトリソグラフィにも使用することができ、生産性にも優れている。

【0056】したがって、本発明を適用すると、非常に信頼性の高い半導体装置が、大幅なコスト上昇を伴わずに提供可能となり、工業的価値が極めて高い。

【図面の簡単な説明】

【図1】ゲート電極のバターニングに用いた反射防止膜から拡散する水素をゲート絶縁膜へ到達させない構造を有する本発明の半導体装置の一構成例を示す模式的断面図である。

【図2】図1のウェハの製造プロセスを示すものであり、タンクステンシリサイド層上に水素透過防止膜を成膜してから、反射防止膜、オフセット酸化膜、フォトレジスト塗膜が形成された状態を示す模式的断面図である。

【図3】図2のウェハにおいて、ゲート電極のバターニングが行われた状態を示す模式的断面図である。

【図4】上層配線のバターニングに用いた反射防止膜から拡散する水素をゲート絶縁膜へ到達させない構造を有する本発明の半導体装置の一構成例を示す模式的断面図である。

【図5】図4のウェハの製造プロセスを示すものであり、ゲート電極を被覆するオフセット酸化膜およびサイドウォール上に水素透過防止膜が成膜され、基板とポリシリコン配線層とが電気的に接続された状態を示す模式的断面図である。

【図6】図5のウェハにおいて、ポリシリコン配線層に電気的に接続するA1配線層が形成され、該A1配線層のバターニングのためにフォトレジスト塗膜が形成された状態を示す模式的断面図である。

【図7】図6のウェハにおいて、A1配線層上のSiO系層間絶縁膜にピア・ホールを開口するためにフォトレジスト塗膜が形成された状態を示す模式的断面図である。

【図8】上層配線のバターニングに用いた反射防止膜から拡散する水素をゲート絶縁膜へ到達させない構造を有する半導体装置の他の構成例を示す模式的断面図である。

【図9】従来の半導体装置の一構成例を示す模式的断面図である。

【図10】図9のウェハの製造プロセスを示すものであり、タンクステンシリサイド層に反射防止膜が成膜された後、オフセット酸化膜、フォトレジスト塗膜が形成された状態を示す模式的断面図である。

【図11】図10のウェハにおいて、ゲート電極のバターニングが行われた状態を示す模式的断面図である。

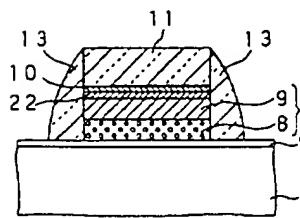
【図12】図9のウェハにおいて、ポリシリコン配線層に電気的に接続するA1配線層が形成され、該A1配線層のバターニングのためにフォトレジスト塗膜が形成された状態を示す模式的断面図である。

【図13】図12のウェハにおいて、A1配線層上のSiO系層間絶縁膜にピア・ホールを開口するためにフォトレジスト塗膜が形成された状態を示す模式的断面図である。

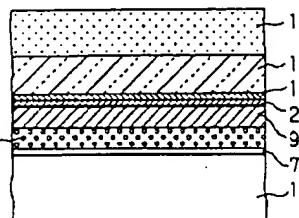
【符号の説明】

- 1 Si基板
- 2 ゲート電極
- 3, 14, 20 SiO系層間絶縁膜
- 4 コンタクト・ホール
- 5 ポリシリコンプラグ
- 6 ポリシリコン配線層
- 7 ゲート絶縁膜
- 8 ポリシリコン層
- 9 タンクステンシリサイド層
- 10, 18 反射防止膜
- 11 オフセット酸化膜
- 12, 19, 21 フォトレジスト塗膜
- 13 サイドウォール
- 15 ピア・ホール
- 16 A1プラグ
- 17 A1配線層
- 22, 23 水素透過防止膜
- 24 水素透過防止層間絶縁膜

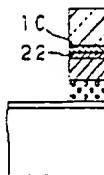
【図1】



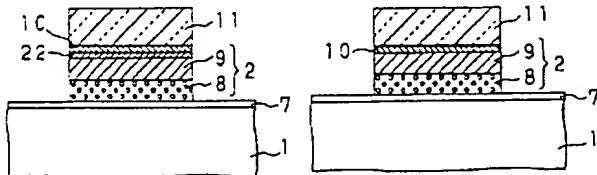
【図2】



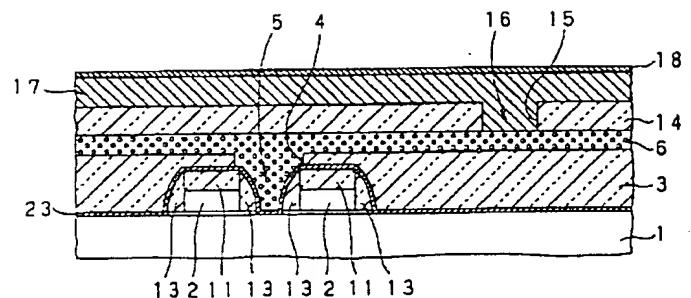
【図3】



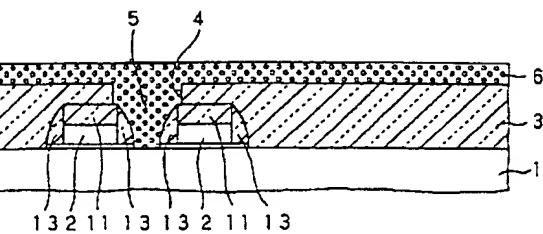
【図11】



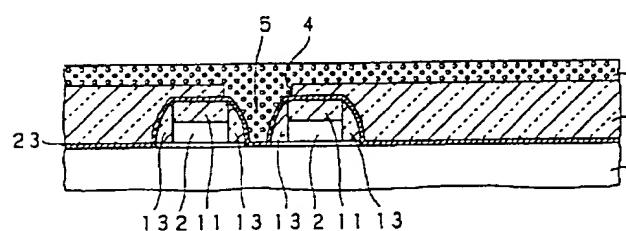
【図4】



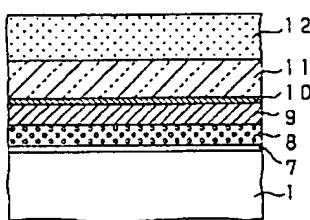
【図9】



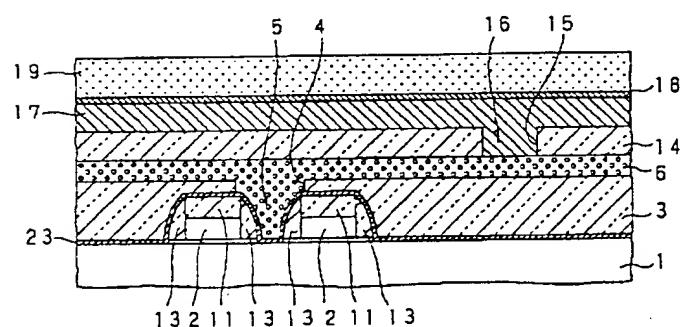
【図5】



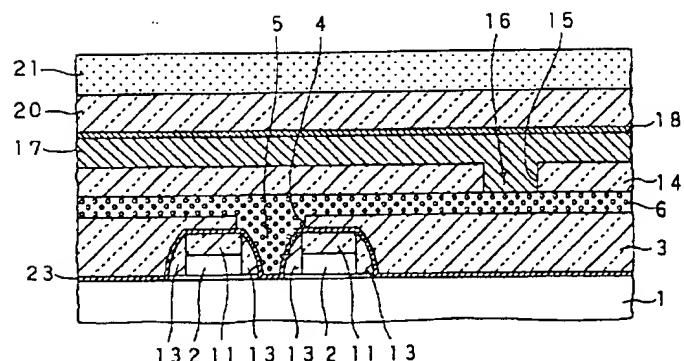
【図10】



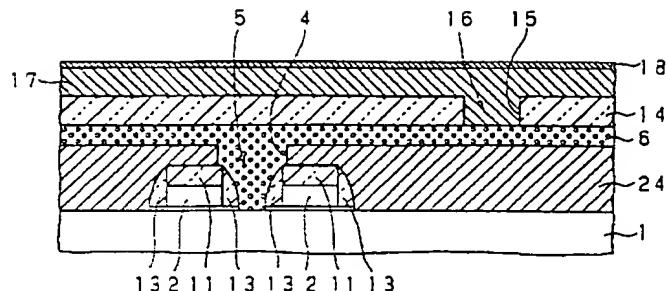
【図6】



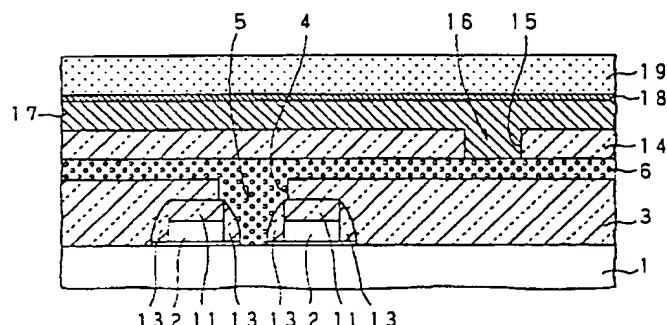
【図7】



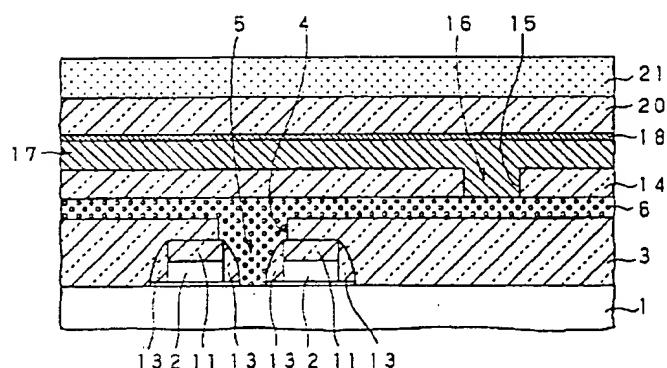
【図8】



【図12】



【図13】



【手続補正書】

【提出日】平成6年9月1日

NH₃ 200 sccm

【手続補正1】

温度 : 760°C

【補正対象書類名】明細書

圧力 : 70 Pa

【補正対象項目名】0037

反射防止膜の成膜条件

【補正方法】変更

成膜装置 : 平行平板プラズマCVD装置

【補正内容】

原料ガス : SiH₄ 50 sccm

【0037】水素透過防止膜の成膜条件

N₂O 50 sccm

成膜装置 : LP-CVD装置

温度 : 360°C

原料ガス : SiH₂Cl₂ 50 sccm

圧力 : 333 Pa

R F 電力 : 190 W

電極間距離 : 1 cm

その後、上述のウェハに対してフォトレジスト塗膜12を全面に亘って塗布し、反射防止膜10によりタングステンシリサイド層9からの強い反射光を防止しながら、フォトレジスト塗膜12の選択露光を行った。続いて、現像処理を施すことによりフォトレジスト塗膜12を所望の形状にバターニングし、これをマスクとして、オフセット酸化膜11、反射防止膜10、水素透過防止膜2、タングステンシリサイド層9、ポリシリコン層8をエッティングした。これにより、図3に示されるように、*

*所望形状のゲート電極2が形成され、該ゲート電極2上では水素透過防止膜22、反射防止膜10、オフセット酸化膜11がゲート電極と共通パターンにバターニングされた。

【手続補正2】

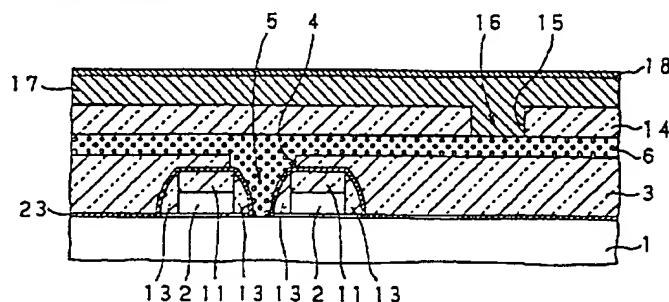
【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図4

【補正方法】変更

【補正内容】

【図4】



【手続補正3】

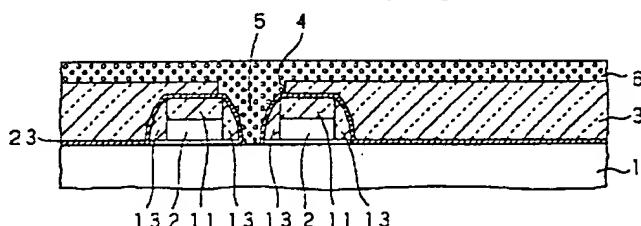
【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図5

※【補正方法】変更

【補正内容】

※【図5】



【手続補正4】

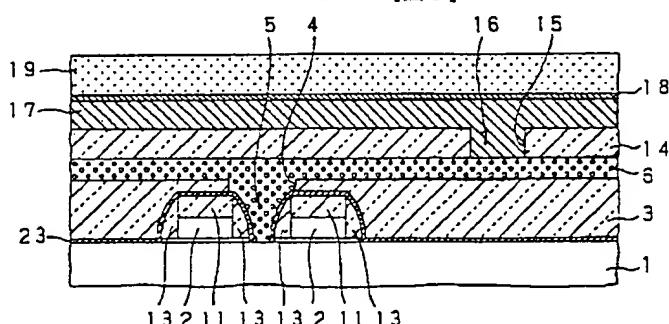
【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図6

★【補正方法】変更

【補正内容】

【図6】



【手続補正5】

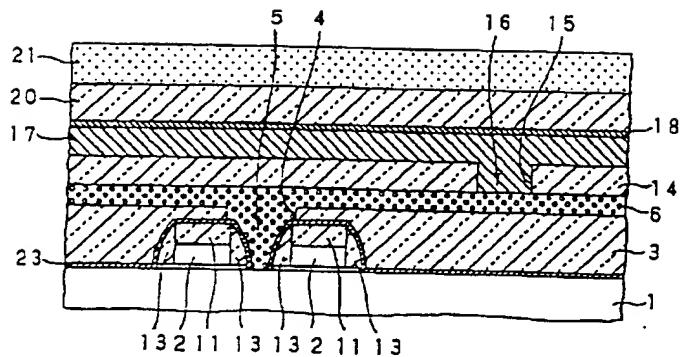
【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図7

【補正方法】変更

【補正内容】

【図7】



フロントページの続き

(51) Int.Cl. 6

H 01 L 21/768

識別記号

庁内整理番号

F I

技術表示箇所

H 01 L 21/90

C